



各 位

平成 28 年 11 月 29 日

会 社 名	日 本 電 子 材 料 株 式 会 社
代 表 者	代表取締役社長 風間 悦男 (コード番号 6855 東証 1 部)
問 合 せ 先	取締役 管理部門統括部長 足立 安孝
電 話	0 6 (6 4 8 2) 2 0 0 7

平成 28 年度近畿地方発明表彰 地域協会会長賞受賞のお知らせ

当社は、平成 28 年度近畿地方発明表彰式にて地域協会会長賞を受賞いたしましたのでお知らせいたします。

記

当社が保有する、微細なプローブをプローブカードへ実装するための技術が、技術的に優秀かつ実施効果が高い特許であると評価され、11 月 28 日に開催された平成 28 年度近畿地方発明表彰において地域協会会長賞を受賞しました。

地方発明表彰は、1921 年に始まった公益社団法人発明協会が主催する顕彰であり、「その発明が地域産業へいかに貢献しているのか」という観点により、全国の優れた技術を 8 つに分けられた各地方で顕彰するものです。

当社は、半導体産業へ一層貢献できるように、今後も新たな技術開発を推進します。

<特許内容>

本特許の対象となった発明は、プローブカードへの正確かつ効率的な実装が要求される、微細なプローブの構造に関する提案です。

近年、微細化された半導体デバイスの検査に用いられるプローブカードには、例えば長さが mm 単位、厚さが数十 μ m 単位の微細なプローブが実装されており、この様なプローブは微細さゆえにプローブカードへ実装する際の取扱いが困難であるという課題がありました。

本発明のプローブは、実装チャックと呼ばれる装置により保持されるための凹部が側面に設けられたものであり、この構造によりプローブは容易に、かつ正確な位置へ実装され易くなっています。

当社は、2013 年に日本において、この構造を第 5235776 号として特許取得しております。

以 上